

Elastyczny klej do parkietu X-BOND MS-K509



- > trwale elastyczny
- > nie zawiera rozpuszczalników ani wody
- > tłumi dźwięki uderzeniowe
- > nie powoduje reakcji alergicznych



Opis produktu

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny klej na bazie technologii MS, nie zawierający wody i rozpuszczalników, bezwonny, tłumiący odgłos kroków. Tłumienie dźwięków uderzeniowych do 14 dB zgodnie z DIN 52210. Nie powoduje reakcji alergicznych. Proces utwardzania kleju następuje w wyniku pochłaniania wilgoci zawartej w otoczeniu. Przeznaczony do przyklejania wszystkich rodzajów posadzek drewnianych z gatunków europejskich i egzotycznych. Szczególnie polecany do parkietów litych, doskonały do desek 2- i 3-warstwowych, również o dużych wymiarach. Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie niezbędna jest szybka zabudowa dużych powierzchni. Do stosowania na podkładach cementowych, podkładach anhydrytowych oraz na podłożach drewnianych i płytach drewnopochodnych np. płytach OSB po przeszlifowaniu. Nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe. Nie stosować na podłoża bitumiczne jak np. lany asfalt. Do stosowania wewnątrz budynków.

Forma dostawy:

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
16 kg / KE		33 szt.

Przechowywanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w suchych warunkach, w temperaturze powyżej +5°C, w oryginalnych opakowaniach.

Okres przechowywania: najlepiej zużyć w okresie 12 miesięcy od daty produkcji.

Obróbka

Zalecane narzędzia:

Szpachla (paca) zębata: B3, B11, B13, B15, B17.

B3 - do parkietu lamelowego, mozaiki tradycyjnej, parkietu gotowego o małych wymiarach i laminatów;

B11- do parkietu (deszczulek parkietowych), parkietu taflowego, mozaiki pałacowej, mozaiki przemysłowej, parkietu lamelowego, mozaiki tradycyjnej, parkietu gotowego;

B13, B15, B17 - do dużych elementów - desek podłogowych, dużych rozmiarów parkietu gotowego i warstwowego

Obróbka:

Jeśli konieczne jest gruntowanie podłoża zastosować grunt D7 lub MS-X3. Przy pomocy odpowiedniej pacy zębatej nanieść klej równomiernie tylko na taką powierzchnię podłoża, jaka może być przykryta parkietem w ciągu około 40-50 minut. Deszczułki parkietowe należy ułożyć na kleju, lekko je dociskając i przesunąć w płaszczyźnie poziomej. Klej powinien zwilżyć całą powierzchnię spodu parkietu. Wokół ścian, słupów i innych przegród pionowych należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm. Lekki ruch pieszy możliwy jest po ok. 12 godz. Parkiet można szlifować najwcześniej po ok. 36 godzinach od klejenia, w zależności od warunków klimatycznych, w jakich układano parkiet oraz wystarczającej aklimatyzacji drewna. Zabrudzenia kleju zmyć kiedy klej jest jeszcze świeży za pomocą chusteczek Murexin R500, stwardniały klej można usunąć jedynie mechanicznie. Podczas klejenia elementów, które nie są połączone na pióro-wpust szczególnie zadbać o to, żeby klej nie wypływał ze szczelin oraz nie znajdował się w szczelinach pomiędzy drewnem (może to powodować sklejenie boczne i niepożądane interakcje z warstwami wierzchnimi).

Należy przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta parkietu.

Dane techniczne

Czas obróbki	ok. 50 - 60 min.
Wytrzymałość końcowa	po ok. 48 godz.
Zużycie	Paca zębata B3, B5, PK/B11, B15: ok. 0,8 - 1,5 kg / m ² Paca zębata B17: ok. 1,8 kg / m ²
Temperatura obróbki	idealna temp. +16°C do +25°C
Ciężar właściwy	1,6 g/cm ³

Świadectwa kontrolne

Sprawdzony zgodnie z (norma, klasyfikacja, ...)

EC1 PLUS

Podłoże

Odpowiednie podłoża:

Nadaje się do stosowania na podkładach cementowych, anhydrytowych i asfaltowych oraz na podłożach drewnianych i płytach drewnopochodnych np. płytach OSB po przeszlifowaniu.

Warunkowo nadaje się na: powierzchnie metalowe, płytki ceramiczne (wymaga zapytania).

Podłoże powinno być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiadać odpowiednim normom i wytycznym. Podłoże musi być suche (podkłady cementowe max 2,0%CM, podkłady anhydrytowe max 0,5% CM, w przypadku ogrzewania podłogowego odpowiednio max 1,8% CM i 0,3% CM), mocne, stabilne, wytrzymałe, bez spękań, jednorodne w przekroju i strukturze, dobrze przeszlifowane, oczyszczone i odkurzone. Warstwy podłoża ograniczające jego chłonność i przyczepność kleju, np. twarde powłoki, mleczo cementowe, mleczo anhydrytowe, stare warstwy klejów lub mas wyrównawczych, itp. należy dokładnie usunąć poprzez szlifowanie, szcztokowanie, frezowanie lub śrutowanie.

Zaleca się, aby minimalna wytrzymałość podłoża na ściskanie była większa niż 20-25 N/mm² (odpowiada to betonowi klasy C20/25 - C25/30 w zależności od klejonej posadzki drewnianej).

Minimalna wytrzymałość podłoża na zrywanie powinna być większa niż 1,0 - 1,5 N/mm² (w zależności od klejonej posadzki drewnianej). Wymagana jest temperatura podłoża powyżej +15°C.

Niepracujące pęknięcia i rysy w podkładzie podłogowym należy sklamrować za pomocą odpowiednich

66021, Elastyczny klej do parkietu X-BOND MS-K509, obowiązuje od: 30.07.2020, Korb Barbara, Strona 2

żywic Murexin: poszerzyć, wykonać nacięcia poprzecznie do rysy co ok. 20÷30 cm na ½ grubości podkładu, dokładnie odkurzyć i umieścić tam kłamy HOCO, a następnie całość wypełnić żywicą 2K SI 60 lub żywicą 2K EP 170 i powierzchniowo, grubo zasypać piaskiem kwarcowym 0,4÷0,8 mm. Ubytki w podłożu uzupełnić używając masy szpachlowej Murexin RS 90 lub Murexin SF 83. Podłoża nierówne lub chropowate należy wyrównać na grubość co najmniej 3 mm używając mas wyrównawczych firmy Murexin.

Masę wyrównawczą po wyschnięciu należy dokładnie wyszlifować i odkurzyć. Słabe podłoża, o niskiej wytrzymałości należy odpowiednio wzmocnić poprzez gruntowanie w systemie Murexin (np. za pomocą żywicy epoksydowej IH 16 oraz / lub przyklejenie Murexin Maty redukującej naprężenia (maty pod parkiet). Podłoża należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące wytyczne, normy i instrukcje.

Podłoża powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiadać odpowiednim normom i wytycznym. Podłoża musi być suche (podkłady cementowe max 2,0%CM, podkłady anhydrytowe max 0,5% CM, w przypadku ogrzewania podłogowego odpowiednio max 1,8% CM i 0,3% CM), mocne, stabilne, wytrzymałe, bez spękań, jednorodne w przekroju i strukturze, dobrze przeszlifowane, oczyszczone i odkurzone. Warstwy podłoża ograniczające jego chłonność i przyczepność kleju, np. twarde powłoki, mleczko cementowe, mleczko anhydrytowe, stare warstwy klejów lub mas wyrównawczych, itp. należy dokładnie usunąć poprzez szlifowanie, szcztokowanie, frezowanie lub śrutowanie. Zaleca się, aby minimalna wytrzymałość podłoża na ściskanie była większa niż 20-25 N/mm² (odpowiada to betonowi klasy C20/25 - C25/30 w zależności od klejonej posadzki drewnianej). Minimalna wytrzymałość podłoża na zrywanie powinna być większa niż 1,0 - 1,5 N/mm² (w zależności od klejonej posadzki drewnianej).

Wymagana jest temperatura podłoża powyżej +15°C. Niepracujące pęknięcia i rysy w podkładzie podłogowym należy sklamrować za pomocą odpowiednich żywic Murexin: poszerzyć, wykonać nacięcia poprzecznie do rysy co ok. 20÷30 cm na ½ grubości podkładu, dokładnie odkurzyć i umieścić tam kłamy HOCO, a następnie całość wypełnić żywicą 2K SI 60 lub żywicą 2K EP 170 i powierzchniowo, grubo zasypać piaskiem kwarcowym 0,4÷0,8 mm. Ubytki w podłożu uzupełnić używając masy szpachlowej Murexin RS 90 lub Murexin SF 83. Podłoża nierówne lub chropowate należy wyrównać na grubość co najmniej 3 mm używając mas wyrównawczych firmy Murexin. Masę wyrównawczą po wyschnięciu należy dokładnie wyszlifować i odkurzyć. Słabe podłoża, o niskiej wytrzymałości należy odpowiednio wzmocnić poprzez gruntowanie w systemie Murexin (np. za pomocą żywicy epoksydowej IH 16 oraz / lub przyklejenie Murexin Maty redukującej naprężenia (maty pod parkiet). Podłoża należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące wytyczne, normy i instrukcje.

Gruntowanie:

Normalnie chłonne, odpowiednio wytrzymałe podłoża mineralne, masy wyrównawcze oraz podłoża drewniane (np. płyty OSB, sklejka) nie wymagają gruntowania.

W przypadku mocno chłonnych podłoży należy je gruntować używając preparatów gruntujących: Grunt dyspersyjny Murexin D7

Podkłady cementowe (nie grzewcze) z wilgocią resztkową do 4% CM należy gruntować (2 warstwy) żywicą epoksydową Murexin EP 70BM, żywicą epoksydową GH50 lub Murexin PU5 i zasypać obficie piaskiem kwarcowym o frakcji 0,4-0,8 mm (min. 2,5 kg/m²).

W przypadku ogrzewania podłogowego podłoża (po cyklu wygrzewania) należy zagruntować Murexin PU5 i obficie zasypać piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 (min. 2,5 kg/m²).

Uwaga:

Po zagruntowaniu podłoża gruntem poliuretanowym Murexin PU 5 można przystąpić do klejenia parkietu klejem X-Bond MS-K-509 po upływie ok. 24 godz. Świeżo zagruntowaną powierzchnię należy zasypać obficie piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 (min. 2,5 kg/m²).

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać kart technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja podpłytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z o.o. Niezależnie od powyższych zaleceń Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.